

(11)Publication number:

2000-103112

(43) Date of publication of application: 11.04.2000

(51)Int.CI.

B41J 2/44 B41J 2/45 B41J 2/455

(21)Application number: 10-274798

29.09.1998

(71)Applicant : KYOCERA CORP

(72)Inventor: OKA SHINJIRO

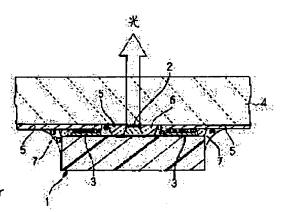
MURANO SHUNJI

(54) OPTICAL PRINTER HEAD

(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical printer head having a light-emitting member capable of being mounted on the optical printer head in a short time, thereby achieving the high productivity. SOLUTION: This optical printer head comprises a light emitting member 1 wherein a plurality of light emitting elements 2 are projected from the top face thereof and a transparent substrate 4 to which a frame body 6 having a slit provided to a position corresponding to each of the light emitting elements 2 is attached. The light emitting member 1 is attached to the lower face of the transparent substrate 4 such that the light emitting element 2 is disposed on the slit of the frame 6. A light permeability of the frame body 6 is set to be not greater than 15%. A light reflectivity of the inner circumference of the frame body 6 is set to be not less than 20%.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's



BEST AVAILABLE COPY

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-103112 (P2000-103112A)

(43)公開日 平成12年4月11日(2000.4.11)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
B41J	2/44		B41J	3/21	L	2 C 1 6 2
	2/45		H04N	1/036	Α	5 C O 5 1
	2/455					
H 0 4 N	1/036					

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)

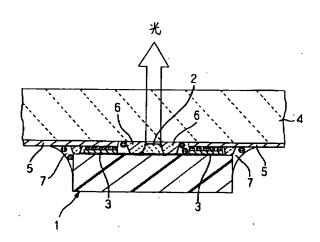
		田里的水 水的水 的水头的数3 OL (主 3 页)
(21)出願番号	特願平 10-274798	(71) 出願人 000006633
		京セラ株式会社
(22)出願日	平成10年9月29日(1998.9.29)	京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6 番地
		(72)発明者 岡 真二郎
		京都府相楽郡精華町光台3丁目5番地 京
		セラ株式会社中央研究所内
		(72)発明者 村野 俊次
		京都府相楽郡精華町光台3丁目5番地 京
		セラ株式会社中央研究所内
		Fターム(参考) 2C162 AE28 FA17 FA70
		50051 AA02 CA08 DB04 DB21 DC02
		DC04 DD02

(54)【発明の名称】 光プリンタヘッド

(57)【要約】

【課題】発光部材を短時間で搭載することが可能な生産 性の高い光プリンタヘッドを提供する。

【解決手段】上面に複数個の発光素子2が突設されている発光部材1と、下面に前記発光素子2に対応する位置にスリット6aが形成された枠体6が被着されている透明基板4とから成り、前記発光部材1を透明基板4の下面に、前記発光素子2が前記枠体6のスリット6a上に配置されるようにして取着させる。また前記枠体6の光透過率を15%以下に設定する。更に前記枠体内周の光反射率が20%以上に設定する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】上面に複数個の発光素子が突設されている 発光部材と、

下面に前記発光素子に対応する位置にスリットが形成された枠体が被着されている透明基板とから成り、

前記発光部材を透明基板の下面に、前記発光素子が前記 枠体のスリット上に配置されるようにして取着させたことを特徴とする光プリンタヘッド。

【請求項2】前記枠体の光透過率が15%以下であることを特徴とする請求項1に記載の光ブリンタヘッド。 【請求項3】前記枠体内周の光反射率が20%以上であることを特徴とする請求項1に記載の光ブリンタヘッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は電子写真プリンタ等 の露光手段として用いられる光プリンタヘッドに関する ものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、電子写真プリンタ等の露光手 20 段としてLEDアレイヘッド等の光プリンタヘッドが用いられている。かかる光プリンタヘッドは、例えば、回路導体が所定バターンに被着されている透明基板の下面に、上面に複数個の発光素子を有した発光部材を複数個、一列状に取着させた構造を有しており、前記発光部材の発光素子を印画データに基づいて個々に選択的に発光させるとともに、該発光した光を透明基板やレンズ等の光学系を介して外部の感光体に照射・結像させ、感光体に所定の潜像を形成することによって光プリンタヘッドとして機能する。 30

【0003】尚、前記発光部材はダイマウンター等によって透明基板上に搭載される。との搭載は画像処理装置を使用したもので、透明基板と発光部材とをこれらの表面に設けておいたマーカー等で位置認識しながら発光部材を位置決めするようにしていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、近年の印画密度の高密度化に伴い、透明基板上への発光部材の搭載には極めて高い位置精度が求められるようになっている。例えば600dpiの印画密度を実現するには発光 40部材の搭載精度を±5μm以内に設定しなければならない。

【0005】しかしながら、このように極めて高い位置精度で発光部材を搭載するには、画像処理装置に使用されるCCDの分解能を上げるために拡大倍率を高めておく必要があり、そのため、高価な画像処理装置が必要となって製造コストの上昇を招くとともに、発光部材の搭載に長時間を要することとなり、その結果、光ブリンタヘッドの生産性が大幅に低下する欠点を有していた。

【0006】更に上述した従来の光ブリンタヘッドにお 50 周知の半導体製造技術、具体的には、まずSi基板を炉

いては、発光部材の各発光素子が発した光はその各々が 僅かずつ放射状に広がりながら外部の感光体に到達す る。そのため、発光素子の発した光(ビーム)を何ら規 制することなく感光体に照射させると、発光部材からの 光の一部が周囲に発散するとともに該発散した光が他の 部材に当たって反射する等して感光体に照射されること があり、その場合、感光体に印画データに対応した所定 の潜像を形成することが不可となる欠点が誘発される。 【0007】またこの場合、発光素子の発した光が放射 10 状に広がることで、感光体に照射される光の強度は低下 するため、感光体表面の潜像が不鮮明なものとなる欠点 も有していた。

[8000]

【課題を解決するための手段】本発明は上記欠点に鑑み 案出されたもので、本発明の光ブリンタヘッドは、上面 に複数個の発光素子が突設されている発光部材と、下面 に前記発光素子に対応する位置にスリットが形成された 枠体が被着されている透明基板とから成り、前記発光部 材を透明基板の下面に、前記発光素子が前記枠体のスリット上に配置されるようにして取着させたことを特徴と するものである。

【0009】また本発明の光プリンタヘッドは、前記枠体の光透過率が15%以下であることを特徴とするものである。

【0010】更に本発明の光プリンタヘッドは前記枠体内周の光反射率が20%以上であることを特徴とするものである。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明を添付図面に基づい 30 て詳細に説明する。図1は本発明の一形態に係る光ブリ ンタヘッドの断面図、図2は図1の光ブリンタヘッドの 透明基板の下面を示す平面図、図3は図1の光ブリンタ ヘッドに使用される発光部材の要部拡大断面図であり、 1は発光部材、2は発光素子、4は透明基板、5は回路 導体、6は枠体、6aはスリットである。

【0012】前記発光部材1は、その上面に直線状に配列され且つ各々が $1\sim10~\mu$ mだけ突設された複数個の発光素子2と、これら発光素子2に電気的に接続された複数個の電極3とを有している。

【0013】前記発光部材1は、その下面に突設した複数個の発光素子2に後述する透明基板下面の回路導体5等を介して外部からの電力が供給されると、発光素子2が印画データに基づいて個々に選択的に発光するようになっており、該発光した光を後述する透明基板4やその上方に配される図示しないレンズ等の光学系を介して外部の感光体に照射させることによって感光体に所定の潜像が形成される。

【0014】尚、前記発光部材しの発光素子5は、例えばAlGaAsの発光ダイオード素子等から成り、従来周知の半導体製造技術、具体的には、まずSi基板を炉

3

中にて髙温に加熱するとともにTMG(トリメチルガリ ウム)とAsH,(アルシン)とTMA(トリメチルア ルミ)を適量に含むガスにSiH、(シラン)を加えて これをSi基板に接触させることによりSi基板表面に n型半導体のA 1 G a A s(アルミーガリウムー砒素) の単結晶を成長させ、次にTMGとAsH,とTMAを 適量に含むガスにDMZ(ジメチルジンク)を加えてこ れを前記A1GaAs単結晶に接触させ、A1GaAs 単結晶の表面にp型半導体のAIGaAs(アルミーガ リウムー砒素)の単結晶を成長させることによって n型 10 半導体のAIGaAs単結晶との間にpn接合を形成 し、このpn接合部を従来周知のエッチング技術やリフ トオフ法等によってパターニングし、pn接合部をSi 基板表面に部分的に残すことで複数個の発光素子2が突 設した状態となり、これを複数個の発光ダイオード素 子、例えば64個の発光素子2を一単位とした発光ダイ オード素子群毎にダイシングすることにより所定の発光 部材1が製作される。

【0015】そして前記発光部材1は従来周知のフェースダウンボンディング法、具体的には、発光部材1の電 20極3を異方性導電接着剤や半田等の導電性接着剤7を介して透明基板下面の対応する回路導体5に接続させるととにより透明基板4の下面に取着・搭載される。

【0016】前記透明基板4は、例えばホウ珪酸ガラスやソーダガラス、石英、サファイア、結晶化ガラス等の透光性を有した電気絶縁材料から成り、その下面で前述の発光部材1や複数個の回路導体5、枠体6などを支持するための支持母材として機能する。尚、前記透明基板4は所定の透光性を有しているため、印画に際して発光部材1の発光素子2を発光させると、該発光した光を透30過させて外部の感光体側に導くことができる。

【0017】また前記透明基板4の下面には複数個の回路導体5が所定バターンに被着される。前記回路導体5は銀(Ag)や銅(Cu),金(Au),アルミニウム(Al)等の金属から成り、先に述べた発光部材1の各発光素子2に外部電源からの電力を供給する給電配線としての作用を為す。

【0018】尚、前記回路導体5は、例えば銀から成る場合、所定の銀ペーストを従来周知のスクリーン印刷等によって透明基板4の下面に印刷し、これを高温で焼き付けることによって透明基板4の下面に例えば2列状をなすように被着・配列される。

【0019】また前記透明基板1の下面には更に、発光部材1の各発光素子2に対応する位置にスリット6aが形成された枠体6が被着される。前記スリット6aは発光素子2の配列に沿って直線状に配列されており、該各スリット6a上には対応する発光素子2がその側面を枠体6の内周に当接させるようにして配置されている。

【0020】とのため、発光部材1の発光素子2を透明 基板4上に搭載して光ブリンタヘッドを組み立てる際、 発光素子2の外形を基準として発光部材4の位置決めを 簡単かつ正確に行うことができるようになり、発光部材 1を、高価な画像処理装置を使用することなく、短時間 で、しかも精度良く透明基板1に搭載することが可能と なる。従って光ブリンタヘッドの生産性が飛躍的に向上 される。

【0021】また前記枠体6の光透過率を15%以下に設定しておけば、各発光素子2の発する光が僅かずつ放射状に広がりながら外部の感光体に到達しようとしても、その広がりが枠体6を超えることは少なくなることから、発光素子2の発した光の周囲への発散が有効に防止され、感光体に印画データに対応した所定の潜像を形成することが可能となる。従って前記枠体6の光透過率は15%以下に設定しておくことが好ましい。尚、このような光透過率15%以下の枠体6は、該枠体6が樹脂から成る場合、該樹脂中にカーボンや酸化鉄、金属等の粉末を所定の比率で添加・混合させておくことにより形成される。

【0022】更に前記枠体内周の光反射率を20%以上 に設定しておけば、各発光素子2の発する光が僅かずつ 放射状に広がりながら外部の感光体に到達しようとして も、その広がりが枠体6を超えることは少なくなる上 に、枠体内周に当たった光の一部を上方に向かって良好 に反射させるとともに該反射光を外部の感光体側に導く ことができるようになり、これによって発光素子2の発 する光 (ビーム) の強度を殆ど低下させることなく、感 光体に照射されるビームの径を所定の大きさとなし、感 光体に鮮明な潜像を形成することが可能となる。従って 前記枠体内周の光反射率は20%以上に設定しておくと とが好ましい。尚、光反射率20%以上の枠体6は、屈 折率が1.2以上の樹脂や金属、ガラス、セラミック等 により形成される。ただし、前記枠体6を金属で形成す る場合は、枠体6と発光部材1との電気的短絡を防止す るために枠体6の表面、もしくは発光部材1の上面をガ ラスやセラミック等から成る電気絶縁層でもって被覆し ておく必要がある。

【0023】また更に前記枠体6の厚みを発光素子2の突出厚みより1~5μmだけ厚くなしておけば、発光素子2の先端が透明基板4の下面に接触することはなく、40発光部材搭載時の発光素子2の損傷が有効に防止される。従って前記枠体6の厚みを発光素子2の突出厚みより1~5μmだけ厚くなしておくこおとが好ましい。【0024】更にまた前記枠体6の角部に曲率半径2~100μmの丸みを設けておけば、枠体6より鋭利な角部が存在しなくなることから、発光部材1を透明基板4上に搭載する際、発光部材1が枠体6と接触しても発光部材1が損傷を受けることはなく、発光部材1を良好な状態で搭載することができる。従って前記枠体6の角部には曲率半径2~100μmの丸みを設けておくことが好ましい。

【0025】尚、前記枠体6は例えば紫外線硬化型樹脂 等から成り、従来周知のフォトリソグラフィー技術やエ ッチング技術等を採用することによって透明基板下面の 所定領域に被着・形成される。より具体的には、例え は、まず透明基板4の下面に紫外線硬化型のアクリル系 樹脂のワニスを従来周知のスクリーン印刷、ディスペン サ、ロールコータ、スピンコータ等によって均一厚さに 塗布するとともに、その上に発光素子2と同じパターン を持った露光マスクを配置し、しかる後、前記ワニスに 前記露光マスクを介して300~400nmの紫外線を 10 照射し、ワニスの一部を光硬化させるとともに残部を現 像によって除去することで透明基板4の下面に所定パタ ーンをなすように被着・形成される。

【0026】また前記発光部材1の透明基板4上への搭 載にはチップマウンタ等が用いられ、該搭載は、まず透 明基板下面の所定領域に異方性導電接着剤等の導電性接 着剤7を被着させた上、該基板4の下面に前記チップマ ウンタを用いて発光部材1を搭載し、しかる後、前記導 電性接着剤7を加熱等によって硬化させることにより行 基板下面の対応する枠体6内に落とし込まれるようにな っており、これによって発光部材1は透明基板4の所定 位置に正確に位置決めされることとなる。尚、ここで用 いるチップマウンタとしては、画像処理による位置決め 機能等を備えていない低価格、低精度のもので十分であ

【0027】かくして上述した本発明の光プリンタへッ ドは、透明基板4の下面に取着させた発光部材1の発光 素子2に回路導体2及び電極6を介して外部からの電力 を印加し、発光素子2を印画データに基づいて個々に選 30 択的に発光させるとともに、該発光した光を図示しない レンズ等の光学系を介して外部の感光体に照射・結像さ せ、感光体に所定の潜像を形成することによって光プリ ンタヘッドとして機能する。

【0028】尚、本発明は上記形態に限定されるもので はなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の 変更、改良等が可能である。

【0029】例えば上記形態では前記スリット6aを1 個の枠体6内に複数個設けるようにしたが、これに代え て枠体を複数個設け、各枠体内にスリットを1個ずつ設 40 けるようにしても構わない。

【0030】また上記形態ではスリット6aを個々の発 光素子2に対応させて設けるようにしたが、これに代え てスリットを発光部材に対応させて設けるようにしても 構わない。この場合、各発光部材に設けられる複数個の 発光素子は1個の細長いスリット上に位置することとな る。

【0031】更に上記形態では枠体6を紫外線硬化型樹 脂を用いて形成するようにしたが、これ以外の材料、例 えば感光性ガラスペースト等を用いて形成するようにし ても構わない。

[0032]

【発明の効果】本発明の光プリンタヘッドにおいては、 発光部材上面に複数個の発光素子を突設させるととも に、透明基板下面の前記発光素子に対応する位置にスリ ットが形成された枠体を被着させ、前記発光部材を透明 基板の下面に、前記発光素子が前記枠体のスリット上に 配置されるようにして取着させたことから、発光部材の 発光素子を透明基板上に搭載して光プリンタヘッドを組 み立てる際、発光素子の外形を基準として前記発光部材 の位置決めを簡単かつ正確に行うことができるようにな り、発光部材を、高価な画像処理装置を使用することな く、短時間で、しかも精度良く透明基板に搭載すること が可能となる。従って光プリンタヘッドの生産性が飛躍 的に向上する。

【0033】また本発明の光プリンタヘッドにおいて なわれる。このとき、発光部材1の各発光素子2は透明 20 は、前記枠体の光透過率を15%以下に設定することに より、各発光素子の発する光が僅かずつ放射状に広がり ながら外部の感光体に到達しようとしても、その広がり が枠体を超えることは少なく、発光素子の発した光の周 囲への発散を有効に防止して感光体に所定の潜像を形成 することが可能となる。

> 【0034】更に本発明の光プリンタヘッドにおいて は、前記枠体内周の光反射率を20%以上に設定すると とにより、各発光素子の発する光が僅かずつ放射状に広 がりながら外部の感光体に到達しようとしても、その広 がりが枠体を超えることは少なくなる上に、枠体内周に 当たった光の一部を上方に向かって良好に反射させると ともに該反射光を外部の感光体側に導くことができるよ うになり、これによって発光素子の発する光(ビーム) の強度を殆ど低下させることなく、感光体に照射される ビームの径を所定の大きさとなし、感光体に鮮明な潜像 を形成することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一形態に係る光ブリンタヘッドの断面 図である。

【図2】図1の光ブリンタヘッドの透明基板の下面を示 す平面図である。

【図3】図1の光プリンタヘッドに使用される発光部材 の要部拡大断面図である。

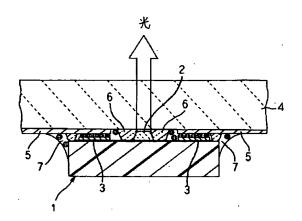
【符号の説明】

1・・・発光部材、2・・・発光素子、3・・・電極、

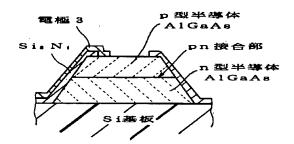
4・・・透明基板、5・・・回路導体、6・・・枠体、

7・・・導電性接着剤





【図3】



【図2】

